





### 持ち上げ制御シーケンス概要

1. 下方向リミットスイッチまで下げる
2. 荷重センサー・位置センサーゼロ点測定
3. 荷重センサーが鏡に触るまでモーター上昇
4. 200um鏡材を持ち上げ(全荷重受け)
5. 荷重平均化フェーズ I (各点制御)
6. 荷重平均化フェーズ II (行列制御)

#### 目標仕様値

- 荷重残差のsigma < 50gf
- 荷重残差の最大値が<100gf

### 目標仕様との比較

#### 固定維持状態での安定性

標準的持ち上げシーケンスの所要時間：3分  
持ち上げ制御後の長期安定性

位置：1um程度以内@半日

荷重：100gfを越える点が3-6時間で出現

これらは十分合格

CGHに影響する(位置の)短期安定性は実際に鏡材・もぐら叩きを研削盤に載せて光学的に測定する予定。

### 支持台の表面加工

支持台には直接教材を載せて加工する  
=>支持台表面はかなりの精度の平面である必要

研削盤に取り付ける面も合わせて平面研削を実施  
が、研削後に表面形状が変化する現象  
砥石冷却用の研削液の蒸発熱の影響

#### 考える対策

- \* 支持基板の構造を変える
- \* 液が金属基板にかからないようにする
- \* 研削時には利用しない

SSDの問題もあり研磨時にのみ形状測定の方針

### 今後の方針

砥粒での加工ではSSDが生じる (1-8um @ #3000)  
最終的な鏡面では除去する必要がある  
=> 研削後、全面を均一に研磨する

予定している全体の加工の流れ

- \* 研削段階では機械精度で行う
- \* SSDを除去する程度に全面を均一に研磨
- \* もぐら / CGHのフィードバックをかけて部分研磨

#### 現状

- \* 研磨軸・研削機の統合制御機構を開発@岐阜
- \* 粗加工から始まる全体のプロセスの立ち上げ